公司代码:603501
转债代码:113616

公司简称:韦尔股份
转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案为:公司拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数,每10股派发现金红利5.20元(含税),预计分配现金红利总额为455,376,768.60元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.17%;同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3.5股,预计转增306,503,595股。

公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案已经公司第五届董事会第五十五次会议审议通过,尚需公司股东大会审议通过。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	韦尔股份	603501	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任冰	周舒扬
办公地址	上海市浦东新区上科路88号东楼	上海市浦东新区上科路88号东楼
电话	021-50805043	021-50805043
电子信箱	will_stock@corp.ovt.com	will_stock@corp.ovt.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司所属行业

根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的行业划分,公司所处行业属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)。

(二)行业发展情况

1、全球半导体行业发展情况

在半导体市场需求旺盛的引领下,2021年全球半导体市场高速增长。根据全球半导体贸易统计协会(WSTS)统计,2021年全球半导体销售达到5,559亿美元,同比增长26.2%。中国仍然是最大的半导体市场,2021年的销售额总额为1,925亿美元,同比增长27.1%。

根据WSTS统计情况,2021年各细分业务领域均表现出了较强的增势,增加率最高的是模拟产品33.1%,其次是内存30.9%和逻辑30.8%。WSTS预计2022年全球半导体市场将继续增长,全球半导体市场将增加10.4%,销售额将达到6,135亿美元,其中传感器、逻辑、模拟设备将是市场增长的主要动力。

2、中国半导体行业发展情况

2021年是中国“十四五”开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计,2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元,同比增长18.2%。其中,设计业销售额为4,519亿元,同比增长19.6%;制造业销售额为3,176.3亿元,同比增长24.1%;封装测试业销售额2,763亿元,同比增长10.1%。

2021年中国集成电路产品进出口都保持较高增速,根据海关统计,2021年中国进口集成电路6,354.8亿块,同比增长16.9%;进口金额4,325.5亿美元,同比增长23.6%。2021年中国集成电路出口3,107亿块,同比增长19.6%,出口金额1,537.9亿美元,同比增长32%。

公司一直从事半导体产品设计业务和半导体产品分销业务。伴随着公司近年来收购整合的顺利完成,公司半导体产品设计业务形成了图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大核心业务体系,并通过团队扩充及并购延伸等方式不断丰富公司产品版图。同时,公司作为国内主要半导体产品分销商之一,凭借着成熟的技术支持团队和完善的供应链管理体系,同全球主要半导体供应商及国内各大模组厂商及终端客户继续保持着密切合作。

(一)半导体设计业务

1、公司采用Fabless的业务模式

公司半导体设计业务属于典型的Fabless模式,公司仅从事集成电路的研发设计和销售,而将晶圆制造、封装测试业务外包给专门的晶圆代工厂商、封装测试厂商,公司从晶圆代工厂采购晶圆,委托集成电路封装测试企业进行封装测试。

公司生产芯片的原材料主要为晶圆。公司将设计的版图交由晶圆代工厂进行掩膜,以制作光罩。晶圆裸片由晶圆代工厂统一采购,公司采购由晶圆代工厂加工、测试后带有多层电路结构的晶圆。公司合作的晶圆代工厂主要为行业排名前列的大型上市公司,市场知名度高,与公司有着长期稳定的合作关系,产品供应稳定。

公司产品的封装测试环节委托封装测试厂商完成。报告期内,公司合作的封装测试厂商主要为封装测试的大型上市公司,经营稳定,市场知名度较高,能够按照产能和周期安排订单生产,报价基于市场化原则,公司与其交易价格公允。

公司产品覆盖的市场范围较广,根据行业、产品及市场需求情况,公司相应选择直销和代销的方式进行销售。总体而言,公司的销售模式以直销为主、代销为辅。公司采用直销模式的客户主要为模组厂商、ODM厂商、OEM厂商及终端客户,直销模式可以保障公司服务效率,根据终端客户的需求及反馈信息以最快的响应速度进行调整。除直销外,公司还通过知名跨国大型经销商进行代销。利用代销模式,公司可有效降低新客户开发的成本,在控制中小规模客户的应收账款回款风险的同时,也降低了公司对中小规模客户销售管理的人力资源及成本支出。

2、公司设计业务产品类型

目前公司半导体产品设计业务主要由图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系构成。具体产品包括以下部分:

业务	产品名称	主要功能	应用领域
图像传感器解决方案	CMOS图像传感器	将接收到的光学信息转换成电信号,是数字摄像头的重要组成部分	消费电子、安防、汽车、医疗、AR/VR等
	微型影像模组封装(CameraCubeChip)	采用先进的芯片级封装技术整合集成晶圆级光学器件和CMOS图像传感器创新的解决方案,可以提供图像传感、处理和单芯片输出的全部功能	医疗、物联网、眼球追踪、AR/VR等
	硅基液晶投影显示(LCOS)	反射模式,尺寸非常小的矩阵液晶显示装置	可穿戴电子设备、移动显示器、微型投影、汽车、医疗等
	特定用途集成电路产品(ASIC)	支持公司CMOS图像传感器,在摄像头和主机之间起到桥梁功能的作用,提供USB、并行、串行接口解决方案以及连接引擎和低功耗图像信号处理等功能	汽车、安防等
触控与显示解决方案	触控和显示驱动集成芯片(TDDI)	接收手机主机输出的图像数据,驱动LCD屏显示,并且能调用户触控信号进行与智能手机的人机交互	智能手机
	显示驱动芯片(DDIC)	负责驱动显示器和控制驱动电流等功能,实现对显示屏成像系统的控制	智能手机
模拟解决方案	TVS	提高整个系统的防静电/抗浪涌电流能力	消费类电子、安防、网络通信、汽车等
	MOSFET	信号放大、电子开关、功率控制等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等
	肖特基二极管	电源整流、电流控向、截波等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等
	LDO	具有过流保护、过温保护、精密基准源、差分放大器、延迟器等功能	消费类电子、安防、网络通信、汽车等
	DC-DC	起调压的作用(开关电源),同时还能起到有效地抑制电网侧谐波电流噪声的作用	消费类电子如笔记本电脑、电视机、机顶盒等
	LED背光驱动	构造一个恒流源电路,确保任何条件下背光LED的发光亮度不变	手机、平板电脑、笔记本电脑、电视机等
	模拟开关	信号切换、功能切换等	消费类电子、安防、网络通信、汽车、工业等
	射频芯片	信号放大、信号传输	移动通信

(二)半导体产品分销业务

1、半导体产品分销业务模式

公司作为典型的技术型半导体授权分销商,与原厂有着紧密的联系。公司拥有经验丰富的FAE队伍,顺应国内半导体行业的产业地域布局,公司分销体系境内外多地设立了子公司,构建采购、销售网络、提供技术支持、售后及物流服务等完整的业务模块。

公司半导体产品分销业务采取买断式采购的模式,具体分为境内采购和境外采购两部分:①境内采购主要由北京京鸿志及其他子公司在境内进行;②境外采购主要由香港华清及其他子公司在境外进行。

基于对半导体元器件性能及下游电子产品的理解及分析,公司主动为客户提供各种产品应用咨询、方案设计支持、协助客户降低研发成本,以使其能够将自身资源集中于电子产品的生产和市场推广,同时也能更好的了解客户的需求,进而使得公司研发设计业务下开发的产品能够顺应市场需求作出迅速的反应。技术型分销能够更好的满足客户对电子产品的理解及需求,代表着半导体元器件分销行业的主流趋势。

2、半导体分销业务产品类型

分销的产品可分为电子元件、结构器件、分立器件、集成电路、显示屏模组等,覆盖了移动通信、家用电器、安防、智能穿戴、工业设备、电力设备、电机控制、仪器仪表、汽车部件及消防等诸多领域。

产品名称	细分产品	主要代理原厂
电子元件	电阻、电容、电感等	松下、乾坤、国巨、三星、华新科、华德等
结构器件	连接器、卡座、卡托、PCB等	Molex、松下、南亚、NIDEC、台达等
分立器件	光电半导体器件、晶振、半导体等	光宝、TXC、TSC、APS等
集成电路	芯片、Sensor、Memory、Flash等	光宝、江波龙、XMC、昆腾微、长江存、景略、荣湃、力生美、芯昇、前海恒飞、海栎信、爱芯、九天睿芯、国民技术等
射频器件	滤波器等	松下、ACX、佳利、芯朴、华新科、新声等
显示屏模组	PMOLED、LCM、AIT等	智瑞、LGD等

公司根据自身代理产品的具体情况并结合市场因素,对所代理的产品线进行动态管理。半导体分销业务是公司了解市场需求的重要信息来源,在维持现有的半导体分销业务销售规模的背景下,公司将下游模组厂商和终端厂商保持紧密合作关系,及时了解市场趋势和终端厂商在研产品需求,有针对性的进行技术研发和储备,使企业的新技术能顺应市场变化,减少下游行业变化带来的负面影响,助力公司半导体设计业务迅速发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	32,079,927,549.91	22,647,992,328.94	41.65	17,476,223,432.68
归属于上市公司股东的净资产	16,198,313,972.34	11,238,642,949.21	44.13	7,926,394,295.30
营业收入	24,103,509,570.58	19,823,965,431.66	21.59	13,631,670,629.57
归属于上市公司股东的净利润	4,476,187,473.66	2,706,109,337.61	65.41	465,632,238.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,002,881,410.48	2,245,073,139.31	78.30	334,201,677.11
经营活动产生的现金流量净额	2,192,411,060.29	3,344,594,067.54	-34.45	806,335,234.79
加权平均净资产收益率(%)	33.06	29.06	增加4.00个百分点	10.17
基本每股收益(元/股)	5.16	3.21	60.75	0.76
稀释每股收益(元/股)	5.14	3.19	61.13	0.73

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,211,809,017.73	6,236,334,919.72	5,866,326,033.32	5,789,039,599.80
归属于上市公司股东的净利润	1,040,832,170.26	1,202,717,165.29	1,274,934,998.81	957,703,142.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	944,202,864.02	1,021,651,349.92	1,101,969,114.49	935,058,082.05
经营活动产生的现金流量净额	482,416,923.01	627,592,842.77	1,400,820,688.21	-318,419,393.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

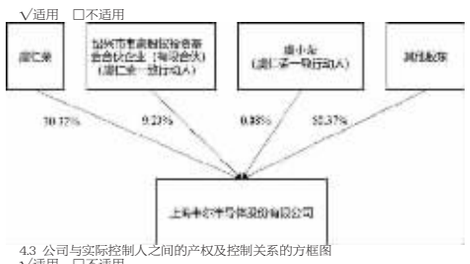
截至报告期末普通股股东总数(户)	42,090
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,239
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
虞仁荣	-13,900,000	265,538,000	30.32	0	质押	102,022,000	境内自然人
绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	80,839,009	9.23	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	30,213,798	75,194,867	8.59	0	无	0	境外法人
青岛融通民和投资中心(有限合伙)	-20,353,957	23,654,064	2.70	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴华清银龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	-7,540,209	14,826,129	1.69	0	无	0	境内非国有法人
嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)	-8,949,624	13,446,718	1.54	0	无	0	境内非国有法人
上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)	-4,787,499	9,314,814	1.06	0	无	0	境内非国有法人
元禾璞华(苏州)投资管理有限公司-合肥元禾华创中台股权投资合伙企业(有限合伙)	-881,500	8,950,460	1.02	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	-5,300,905	8,750,459	1.00	0	无	0	境内非国有法人
Seagull Strategic Investments(A3),LLC	-13,561,799	8,489,711	0.97	0	无	0	境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)为虞仁荣先生控制的企业,虞小荣先生系虞仁荣先生弟弟,均为虞仁荣先生一致行动人;嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、北京华清博广创业投资有限公司均为吕大龙先生控制的企业,嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、北京华清博广创业投资有限公司互为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

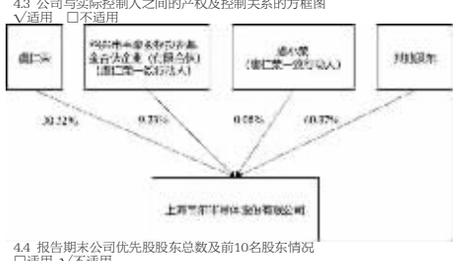
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
长三角科创企业2020年度第一期集合短期融资券	20长三角科创集合CP001	042000465	2021年10月30日	0	3.30

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
长三角科创企业2020年度第一期集合短期融资券	公司参与的长三角科创企业2020年度第一期集合短期融资券于2020年10月29日成功发行。本期短期融资券集合发行总额为人民币6亿元,其中公司发行金额为人民币2亿元,票面利率为3.30%,期限为366天,起息日期为2020年10月30日,兑付日期为2021年10月30日。公司已完成本期短期融资券的兑付工作,本息兑付总额共计人民币20,660万元。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	49.18	49.11	0.07
扣除非经常性损益后净利润	400,288.14	224,507.31	78.30
EBITDA全部债务比	40.19%	34.79%	15.52
利息保障倍数	13.19	9.04	45.91

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期内,公司营业总收入241.04亿元,较2020年增长21.59%;公司归属于母公司股东的净利润为44.76亿元,比2020年增长65.41%。

2 公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603501	证券简称:韦尔股份	公告编号:2022-032
转债代码:113616	转债简称:韦尔转债	

上海韦尔半导体股份有限公司关于重大资产重组标的资产2021年度业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1001号),核准公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)等39名交易对方发行股份购买其持有的北京豪威科技有限公司(以下简称“北京豪威”)85.53%的股权、北京思比科微电子技术股份有限公司(现已更名为“豪威科技(北京)股份有限公司”,以下简称“思比科”)42.27%的股权、北京视信源科技发展有限公司(以下简称“视信源”)79.93%的股权并非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元(以下简称“本次重大资产重组”),公司于2019年8月完成了本次重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》,现就2021年度本次重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况说明如下:

一、本次重大资产重组基本情况

1.2018年11月30日,公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了本次重大资产重组事项。2018年12月17日,公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过本次重大资产重组方案及相关议案。

2.2019年6月21日,公司收到中国证监会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司向绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1001号),核准公司向交易对方合计发行400,951,447股股份购买资产,并非公开发行股份募集配套资金不超过200,000万元。

3.2019年7月30日,北京豪威85.53%的股权、思比科42.27%的股权、视信源79.93%的股权已过户至公司名下,相关工商变更手续已办理完成。

4.2019年8月5日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《上海韦尔半导体股份有限公司验资报告》(信会师报字[2019]第ZA15325号),截至2019年7月30日止,上海韦尔半导体股份有限公司已取得北京豪威85.53%股权、思比科42.27%股权、视信源79.93%股权,上述公司股权已过户至韦尔股份名下,并完成了相关股权变更登记手续。变更后的注册资本为人民币856,655,387.00元,变更后的股本为人民币856,655,387.00元。

5.2019年8月21日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具《上海韦尔半导体股份有限公司验资报告(截至2019年8月21日)》(信会师报字[2019]第ZA15427号),确认截至2019年8月21日止,公司本次非公开发行人民币普通股(A股)募集资金总额为人民币404,147,090.48元,扣除发行费用人民币37,291,138.43元后,实际募集资金净额为人民币366,855,952.05元,其中,计入股本金额为人民币7,006,711.00元,计入资本公积(股本溢价)金额为人民币359,849,241.05元。变更后公司的注册资本为人民币863,662,098.00元,股本为人民币863,662,098.00元。

6.2019年8月28日,公司已完成本次发行股份购买资产的新增限售流通股400,951,447股的股份登记以及非公开发行股份募集配套资金的新增限售流通股7,006,711股的股份登记。公司已于当日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

二、业绩承诺情况

(一)北京豪威业绩承诺方

根据本公司与北京豪威业绩承诺方绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“绍兴韦豪”)、青岛融通民和投资中心(有限合伙)、Seagull Strategic Investments (A3), LLC、嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙)、上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙)、Seagull Investments, LLC、合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙)、北京集成电路设计与封测股权投资中心(有限合伙)(以下简称“北京华创”)、共青城威熠投资有限公司、Seagull Strategic Investments (A1), LLC、Seagull Equity Investments (C1-Int'l) (Hong Kong) Limited、Seagull Equity Investments (C1), LLC、虞仁荣签署的《上海韦尔半导体股份有限公司与北京豪威科技有限公司部分股东及虞仁荣之利润补偿协议》、北京豪威2019、2020及2021年度内实现的净利润诺数(指北京豪威在盈利承诺期内实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)不低于54,541.50万元、84,541.50万元及112,634.60万元。

2019年5月17日,承诺方虞仁荣和绍兴韦豪分别出具了《关于补充利润补偿的承诺函》,承诺虞仁荣和绍兴韦豪将按照《利润补偿协议》列明的承诺净利润数与北京豪威技术研发材料费用资本化对当期净利润的预测影响金额之和作为新的承诺净利润数,具体为北京豪威2019、2020及2021年度内实现的净利润承诺数不低于59,938.87万元、88,481.57万元及115,146.55万元。

(二)思比科业绩承诺情况

根据本公司与思比科业绩承诺方:北京华清博广创业投资有限公司、吴南健、陈杰、刘志君签署的《上海韦尔半导体股份有限公司与北京思比科微电子股份有限公司部分股东之利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》,思比科2019、2020及2021年度内实现的净利润承诺数(指思比科在盈利承诺期内实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)不低于2,500万元、4,500万元及6,500万元。

(三)视信源业绩承诺情况

根据本公司与视信源业绩承诺方陈杰、刘志君、旷章曲、董德福、程杰、钟萍、吴南健签署的《上海韦尔半导体股份有限公司与北京视信源科技发展有限公司部分股东之利润补偿协议》及《利润补偿协议之补充协议》,视信源2019、2020及2021年度内实现的净利润承诺数(指视信源在盈利承诺期内实现的经具有证券期货业务资格的会计师事务所审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润)不低于1,346万元、2,423万元及3,500万元。

三、业绩承诺实现情况

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司净利润实现数与净利润承诺数差异情况说明及专项审核报告》(普华永道中天特审字(2022)第3596号)及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海韦尔半导体股份有限公司购买标的资产业绩承诺实现情况的专项审核报告》信会师报字[2022]第ZA11027号,公司重大资产重组标的资产2021年度业绩承诺实现情况如下:

(一)北京豪威业绩实现情况

剔除配套募集资金产生的影响,北京豪威2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为318,416.43万元,2021年度的净利润实现数已实现净利润承诺数,对于虞仁荣及绍兴韦豪实现率为276.53%,对于除虞仁荣及绍兴韦豪外其他承诺方实现率为282.70%。

(二)思比科业绩实现情况

思比科2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为13,702.17万元,2021年度的净利润实现数已实现净利润承诺数,业绩承诺方业绩实现率为210.80%。

(三)视信源业绩实现情况

视信源2021年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,374.13万元,2021年度的净利润实现数已完成净利润承诺数,业绩承诺方业绩实现率为210.69%。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2022年4月19日

证券代码:603501	证券简称:韦尔股份	公告编号:2022-036
转债代码:113616	转债简称:韦尔转债	

上海韦尔半导体股份有限公司关于2021年度关联交易及2022年度预计关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:是

●公司与关联方发生的日常关联交易根据公平、公正、自愿、诚信的原则进行,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成依赖。

●2022年4月18日,上海韦尔半导体股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第五十五次会议、第五届监事会第四十九次会议,审议通过了《关于公司2021年度关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案》,该事项尚需提交至公司股东大会审议。

一、2021年度关联交易情况

(一)2021年度偶发关联交易履行的审议程序

公司2021年7月5日,公司召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于购买公司控股子公司少数股权暨关联交易的议案》,公司以现金方式由韦尔半导体香港有限公司收购苏州聿泉华创股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“聿泉华创”)持有的标的公司30%的股权,因聿泉华创为公司董事刘越女士控制的企业,聿泉华创为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

2021年10月21日,公司召开第五届董事会第四十八次会议,审议通过了《关于参与认购北京君正向特定对象发行股票暨关联交易的议案》,公司全资企业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业(有限合伙)拟以自有资金人民币55,000万元参与认购北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票。鉴于公司董事陈智斌先生为北京君正集成电路股份有限公司股东北京华创芯原科技有限公司董事,北京华创芯原科技有限公司为公司关联法人,本次交易构成关联交易。

(二)2021年度日常关联交易履行的审议程序

2021年4月15日,公司召开第五届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于公司2020年度关联交易及2021年度预计日常关联交易的议》;2021年6月10日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了上述议案,公司独立董事认为,公司与相关关联方进行的关联交易,遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,不会因本次交易而对关联人形成依赖,也不会对公司独立性产生影响。

(三)2021年度日常关联交易的发生情况

2021年度日常关联交易执行具体情况如下表所示:

单位:万元/人民币

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额
向关联人购买原材料	江苏韦达半导体有限公司	1,200.00	1,103.64
其他	上海韦城公寓管理有限公司	850.00	651.06
向关联人销售产品	北京极豪科技有限公司	2,000.00	1,882.61
其他	上海芯橙集成电路有限责任公司	120.00	118.96
其他	无锡韦感半导体有限公司	550.00	462.90

(四)其他说明

1、关联担保情况

本公司及子公司不存在为合并报表外关联方提供担保的情况。

(1)公司及子公司作为担保方

单位:万元/人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海韦矽微电子有限公司	100,000,000.00	2021/6/18	2022/6/17	否
香港华清电子(集团)有限公司	48,992,408.97	2021/10/25	2022/3/23	否
豪威科技(北京)股份有限公司	10,000,000.00	2021/2/23	2022/2/10	否
豪威科技(北京)股份有限公司	10,000,000.00	2021/10/26	2022/10/16	否
豪威科技(北京)股份有限公司	19,127,100.00	2021/4/23	2022/4/13	否

(2)本公司作为被担保方

单位:万元/人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
虞仁荣、韩士健	180,000,000.00	2021/6/18	2022/6/15	否
虞仁荣、韩士健	100,000,000.00	2021/11/18	2022/2/18	否
虞仁荣、韩士健	100,000,000.00	2021/10/19	2022/1/19	否
虞仁荣、韩士健	100,000,000.00	2021/7/9	2022/4/30	否
虞仁荣、韩士健	90,000,000.00	2021/2/10	2022/1/11	否
虞仁荣	195,000,000.00	2021/8/13	2022/8/12	否
虞仁荣	300,000,000.00	2021/1/8	2022/1/7	否
虞仁荣	5,000,000.00	2021/8/13	2022/8/12	否
虞仁荣、韩士健	210,000,000.00	2021/3/2	2022/3/2	否
虞仁荣	100,000,000.00	2021/4/9	2022/4/9	否
虞仁荣、韩士健	50,000,000.00	2021/6/24	2022/6/23	否
虞仁荣、韩士健	100,000,000.00	2021/3/24	2022/3/23	否
虞仁荣、韩士健	50,000,000.00	2021/6/24	2022/6/23	否
虞仁荣、韩士健	20,000,000.00	2021/1/15	2022/1/15	否
虞仁荣、韩士健	30,000,000.00	2021/1/15	2022/1/15	否
虞仁荣、韩士健	750,000,000.00	2019/7/16	2024/7/4	否
虞仁荣、韩士健	234,824,426.16	2020/6/21	2025/6/19	否
虞仁荣、韩士健	30,000,000.00	2020/7/13	2025/7/12	否
虞仁荣、韩士健	50,000,000.00	2020/7/21	2023/7/20	否
虞仁荣、韩士健	40,000,000.00	2020/9/27	2023/9/16	否
虞仁荣、韩士健	290,500,000.00	2020/10/26	2023/10/20	否
虞仁荣、韩士健	240,000,000.00	2020/11/16	2022/11/15	否
虞仁荣、韩士健	59,500,000.00	2020/11/30	2023/11/29	否
虞仁荣、韩士健	80,000,000.00	2021/2/10	2023/9/16	否
虞仁荣、韩士健	170,000,000.00	2021/6/11	2024/6/10	否
虞仁荣、韩士健	113,563,794.25	2021/6/23	2023/6/22	否
虞仁荣	196,770,000.00	2021/7/27	2024/7/26	否
虞仁荣、韩士健	131,000,000.00	2021/8/23	2024/8/22	否
虞仁荣、韩士健	75,000,000.00	2021/8/30	2024/8/29	否
虞仁荣	50,000,000.00	2021/11/23	2023/11/22	否

2、上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形,上述人员近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

(三)审计收费

审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币260万元,2021年度内部控制审计服务报酬为人民币90万元,两项合计为人民币350万元。2022年度公司审计费用将以2021年度审计费用为基础,根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计和关联交易控制委员会意见

公司第五届审计和关联交易控制委员会对立信的基本情况材料进行了充分的了解,并对其在2021年度的审计工作进行了审核,认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格,在为公司提供2021年度审计服务工作中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金并购买相关职业保险,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,具备较好的投资者保护能力。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(二)独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见,独立董事认为:根据对立信的相关了解,认为其在为公司提供审计服务过程中,严格遵循独立、客观、公正的执业准则,对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是,所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性,独立董事同意续聘立信为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见,独立董事认为:立信具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力,熟悉公司业务。基于公司与其多年良好的合作关系,同时考虑公司财务审计业务的连续性,同意续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,并同意将该议案提交至公司股